

性能特点：

- 频带：3~9GHz
- 插入损耗：0.7dB
- 插损波动：±0.2dB
- 隔离度：20dB
- 输入/输出电压驻波比：1.4/1.3
- 芯片尺寸：1.2mm×1.0mm×0.075mm

产品简介：

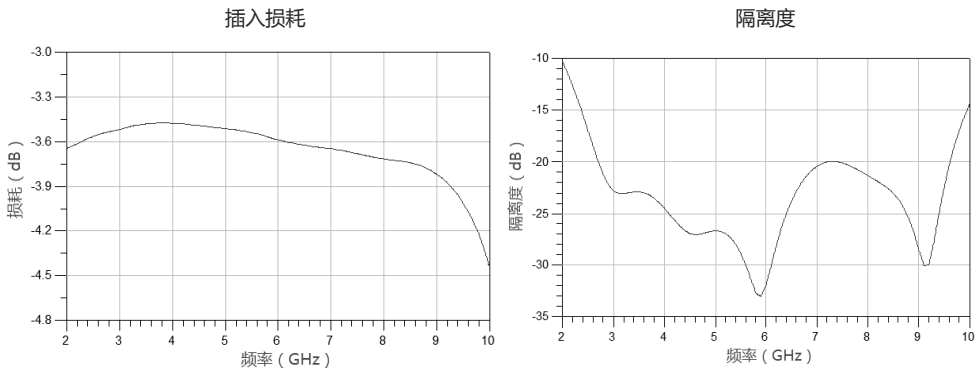
HH-PD0309V 是一款 GaAs MMIC 0°两路功分器芯片，该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、易集成等特点，广泛应用于功率分配及合成。其频率范围覆盖 3~9GHz，整个频带内插入损耗小于 0.9dB。

电参数： ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

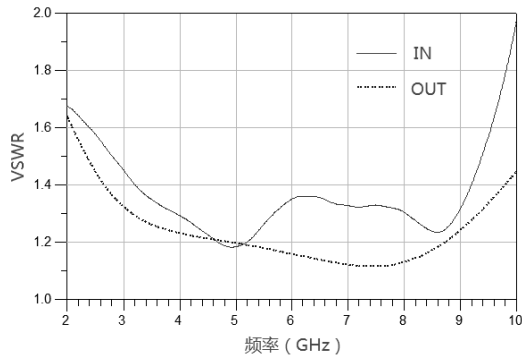
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	3~9			GHz
插入损耗	0.5	0.7	0.9	dB
插损波动	-	-	±0.2	dB
隔离度	-	20	-	dB
输入驻波比	1.5	1.4	-	-
输出驻波比	1.4	1.3	-	-

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

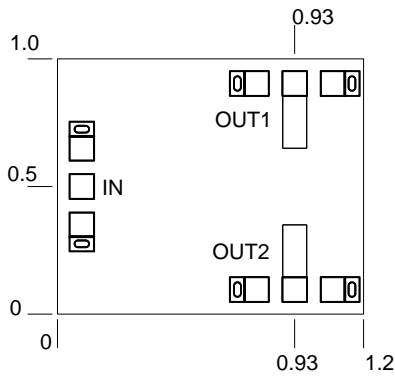
输入功率	+37dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

典型曲线：


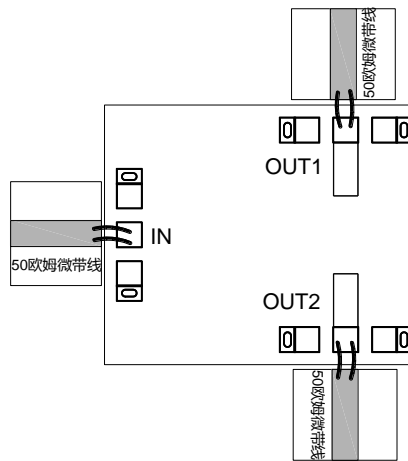
驻波比



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。